

有研半导体材料股份有限公司

关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】279号）核准，非公开发行人民币普通股 60,349,434 股，发行价格为每股 9.73 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 587,199,992.82 元，扣除发行费用人民币 15,150,000 元后，公司本次非公开发行募集资金净额为人民币 572,049,992.82 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2013】第 710455 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及《有研半导体材料股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司在中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行（以下简称“开户行”）开设账户作为非公开发行股票募集资金专项存储账户，公司及公司的全资子公司国宇半导体材料有限责任公司、本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）与开户行签订了非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：

一、公司已在开户行行开设本次发行募集资金专用账户（以下简称“专户”），账号分别为 0200010029200442911。上述专户仅用于本次非公开发行人民币普通股股票的募集资金的存储和使用，不得作其他用途。

二、中信建投证券作为公司本次发行的保荐机构，根据有关规定指定保荐代

表人或其他工作人员对本次发行募集资金使用情况进行监督。

三、公司授权中信建投证券指定的保荐代表人赵自兵、庄云志可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

四、开户行按月（每月 5 日之前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信建投证券。

五、公司若 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到本次发行募集资金净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。

六、中信建投证券发现公司、开户行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司

2013 年 4 月 20 日